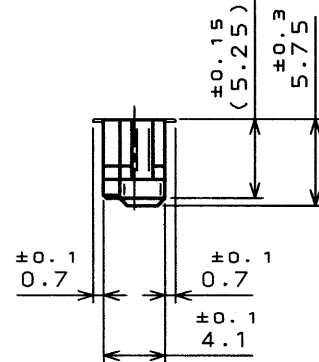
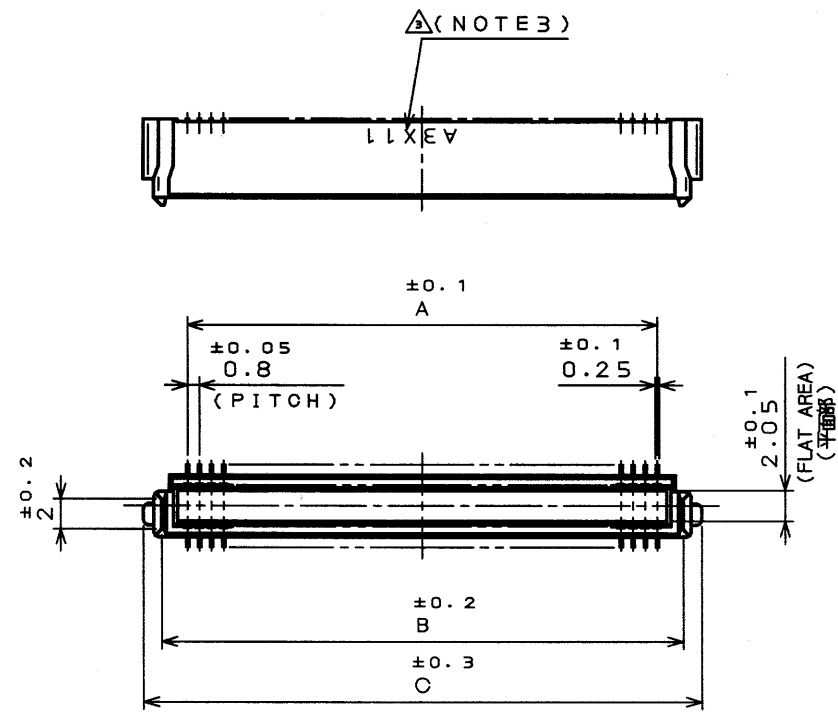


SJ027510
(ON DRAWING) 台番号

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	7.Dec.1993	32797	ADDED KIND OF FINISH(TABLE 2)		K.HISATOMI		H.YASUI
3	28.Sep.2001	48678	REVISED LOT NUMBER MARKING	H.SAKURADA	K.KAWASE	M.Watamabe	H.Amomija



DESIGNATION

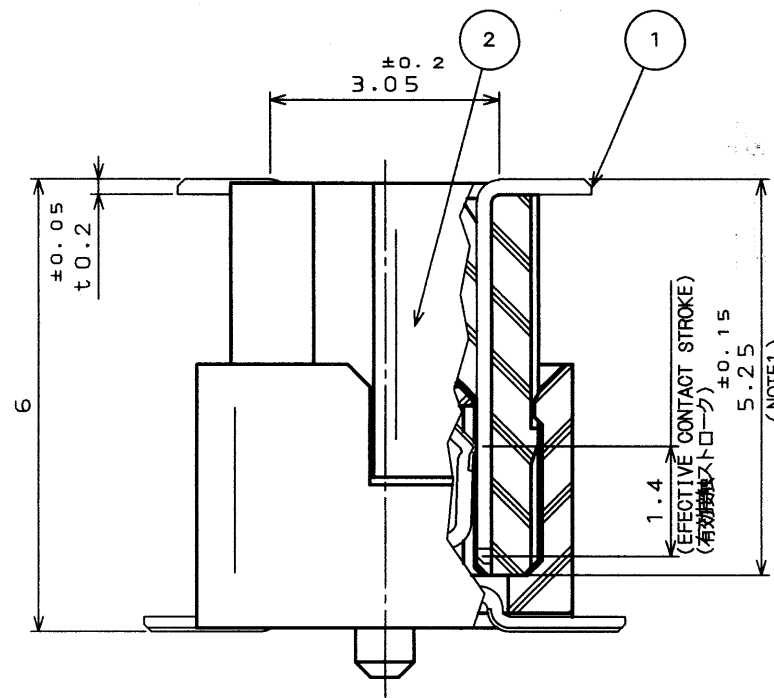
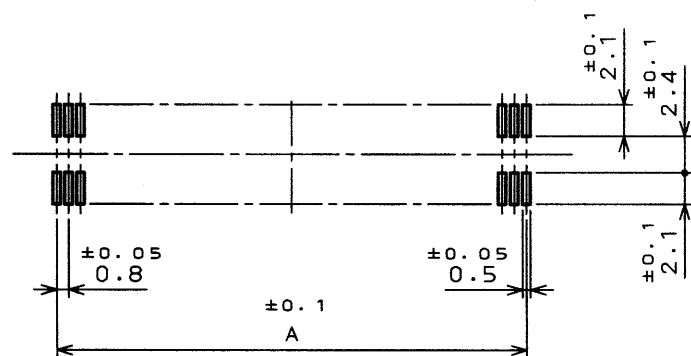
命名法
K X 1 5 - * * K 4 *

SERIES PREFIX シリーズ
14: RECEPTACLE
15: PLUG
14: レセプタクル
15: プラグ

NUMBER OF CONTACT 芯数

△ CONTACT FINISH (TABLE 2)
コンタクト仕上(表2参照)
STACKING HEIGHT PER ONE SIDE, KX** (NOTE2)
平行基板間高さ(注2)
N: WITHOUT MISMATING PREVENTION KEY
K: WITH MISMATING PREVENTION KEY
N: 逆挿入防止キイ無
K: 逆挿入防止キイ有

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)



MATED CONDITION (REF)
(SCALE 10:1)

NOTE1. COPLANARITY: 0.1mm MAX.
2. STACKING HEIGHT = HEIGHT OF KX14 (RECEPTACLE) + HEIGHT OF KX15 (PLUG)
EX.: KX14-***K2, KX15-***K4 6mm=2+4

- 注1. 端子の平坦度は、0.1以下。
2. KX14(レセプタクル)の数と、KX15(プラグ)の数とを加えた値が平行基板間高さになります。
3. 図示の面に、ロット番号を表示する。

(EX.) A 3 X 1 1 △
(例) LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
月の生産ロット番号
MONTH(1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY,
OCT.: 0 NOV.: X, DEC.: Y)
月表示: 1~9(10月: 0, 11月: X, 12月: Y)
YEAR (LAST DIGIT ONLY)
年表示(西暦末尾)
MANUFACTURER CODE
製造コード

TABLE 1 DIMENTION
表1 寸法

No. OF CONTACT 芯数	A	B	C
50	19.2	22.6	25

TABLE 2 CONTACT FINISH
表2 仕上

FINISH 仕上記号	CONTACT AREA 接触部仕上	TERMINAL AREA 端子部仕上
NONE 無印	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni/Au0.1μm以上	GOLD FLASH OVER NICKEL Ni/Auフラッシュ
1	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni/Au0.1μm以上	TIN-LEAD OVER NICKEL Ni/上SnPb

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PPS		COLOR: BLACK
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	TABLE 2 △	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1401-*		第1版(ORIGINAL DATE) 31.May.1993		尺慮(SCALE) 2:1	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) △ KX15-***K4* PLUG	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK. K.HISATOMI		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
. ±0.8		査閲 APPD.		図面番号(DRAWING NO.) SJ027510	
.X ±0.4		承認 APPD. N.KAWABE		版数 (REV.) 3	
.XX ±0.1				重量(WEIGHT)	
.XXX ±				製造コード	